

臻鼎舉辦 2026 全球合作夥伴大會暨鵬鼎深圳第三園區智慧製造基地動土典禮，攜手供應鏈打造 AI 時代高階 PCB 新生態

全球 PCB 領導大廠臻鼎科技控股股份有限公司(股票代號:4958)今日(24 日)於深圳舉辦「2026 全球合作夥伴大會暨鵬鼎深圳第三園區智慧製造基地動土典禮」，邀集來自全球的合作夥伴、政府代表及產業專家齊聚一堂。此次活動不僅象徵新園區正式啟動建設，更是臻鼎與全球合作夥伴攜手邁向 AI 新時代的誓師大會，展現集團加速布局 AI 高階應用、深化智慧製造與供應鏈協同的長期承諾。

董事長沈慶芳於動土典禮致詞時表示，AI 正以前所未有的速度重塑全球產業，從 AI 伺服器、高速光模塊，到 AI 終端、智能車，高階 PCB 已成為支撐 AI 時代的重要「基礎設施」。隨著 AI 快速發展，高階 PCB 需求朝向高密度、高層數、高可靠度方向發展，PCB 產業正迎來新的發展契機。

沈慶芳強調，深圳第三園區是臻鼎因應 AI 時代發展的重要戰略布局，也是臻鼎從「消費電子基本盤」向「AI 賽道」第二增長曲線躍升的關鍵一步。園區規劃總建築面積約 50 萬平方公尺，預計總投資金額超過人民幣 100 億元，重點布局 AI 伺服器用與光模塊用高階類載板，以及 AI 終端用高階軟板等高端產能，並導入智慧製造、自動化及數位化管理系統。目前集團已建成 28 棟廠房，另有 13 棟建設中、16 棟規劃中，預計至 2030 年將有 57 棟廠房投入生產，持續強化集團全球高階 PCB 供應能力。

下午舉辦的全球合作夥伴大會除分享集團未來發展策略外，亦以「AI 算力革命下異質整合的機遇與挑戰」為論壇主軸，深入探討 AI 算力革命如何推動半導體、IC 載板、PCB、智慧製造及終端應用的全面升級，並表揚在 ESG、品質、技術創新及服務等面向表現卓越的合作夥伴。

沈慶芳於全球合作夥伴大會表示，PCB 作為電子產品之母，每一次科技世代的演進都推動 PCB 市場規模與技術門檻同步提升。在 AI 快速發展帶動下，今年全球 PCB 產值可望首度突破 1,000 億美元，並開啟長期成長的新週期，正式迎來 PCB 產業的「黃金十年」。

沈慶芳進一步引用 NVIDIA 執行長黃仁勳提出的「AI 五層蛋糕」概念，從最底層的能源，往上延伸至晶片、AI 基礎建設、模型到各種應用，每一層都離不開 PCB；AI 帶動 PCB 需求持續增加，也推動產品規格全面升級。如今，PCB 已從訊號傳輸載體，進一步成為影響 AI 系統效能與可靠度的關鍵要角。

隨著產品技術門檻、製造複雜度及供應鏈協同要求持續提高，未來的競爭也將從單一企業之間的競爭，進一步轉向整體產業鏈與生態系的競爭。沈慶芳表示，臻鼎將持續深化與材料、設備、及全球供應鏈夥伴的合作，透過共同研發、製程升級與資源整合，加速高階 PCB 技術落地，並共同提升供應鏈效率、品質與韌性，攜手掌握 AI 時代帶來的長期成長機會。

展望未來，沈慶芳表示，臻鼎始終秉持掌握市場趨勢、發展高階產品、與世界一流客戶共同成長的策略，持續深化 One ZDT 平台，整合集團軟板、高多層板(HLC)、HDI、及 IC 載板等完整產品線，積極布局 AI「雲、管、端」全產業鏈。從 AI 伺服

器、高速光模塊，到未來的 AI 眼鏡、人形機器人、低空經濟及腦機介面等 Edge AI 應用，臻鼎都將持續深化全球布局，攜手全球合作夥伴，共同迎向 AI 時代下一個黃金十年。



(上圖)為深圳第三園區動土典禮沈董事長致詞

關於臻鼎科技控股

臻鼎科技控股股份有限公司(台灣證券交易所股票代號: 4958)主要從事研發、生產及銷售多樣化之軟性電路板與模組、類載板、高密度連接板、高多層及高密度印刷電路板(HLC-HDI)、多層硬板、IC 載板等產品，廣泛應用於電腦資訊、消費性電子產品、通訊網路、車用電子、AI 伺服器高速運算、光模塊與醫療等領域，提供客戶一站式購足全方位解決方案的專業服務公司。根據 Prismark 以營收計算的全球 PCB 企業排名，臻鼎 2017 年至 2025 年連續九年榮登全球最大 PCB 生產企業，更多詳細資訊請至公司網站: www.zdtco.com。

公司發言人:

凌惇

公司治理暨投資人關係處

電話: 886 3 3830101

Email: duen.t.ling@zdtco.com